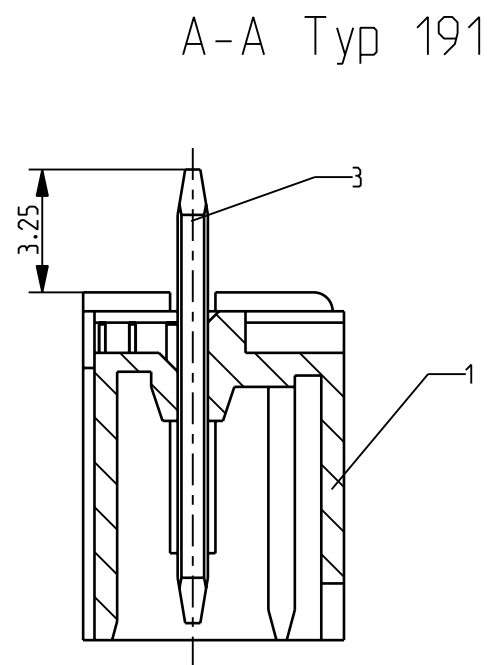
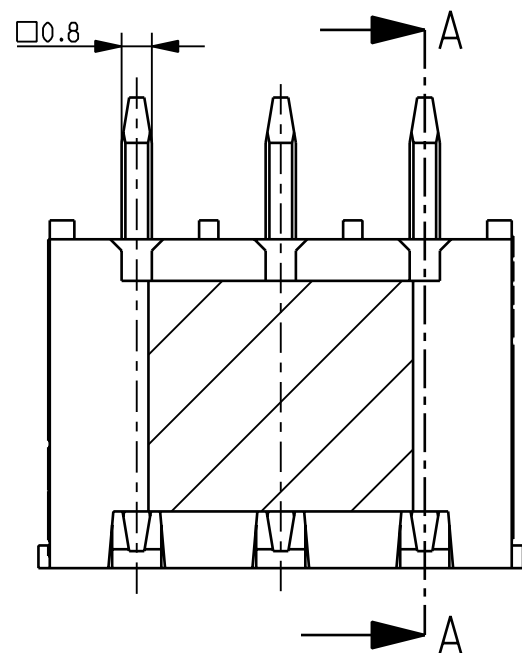
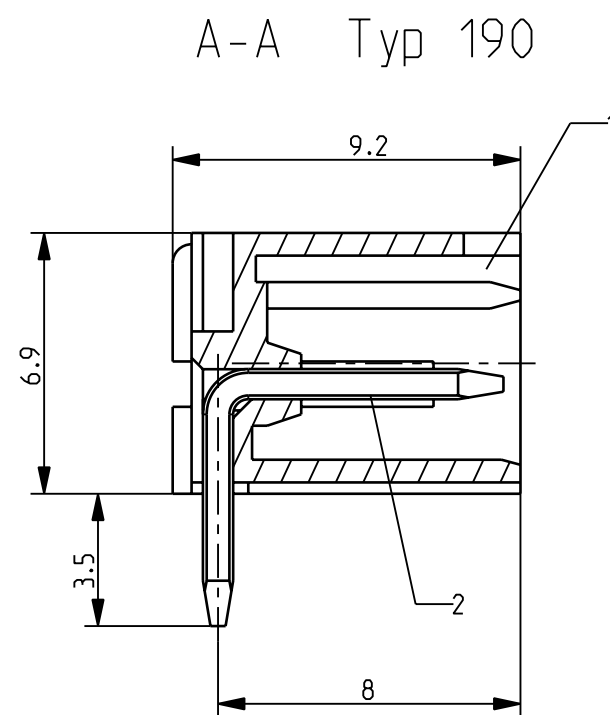
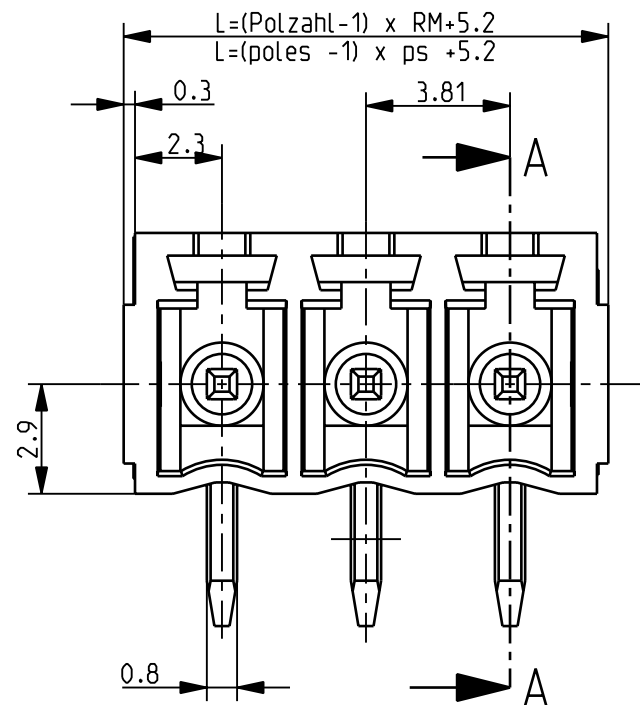


Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden. This drawing shall remain the property of RIA and shall not be reproduced, used in any way by the receiver or any third party, without our prior full agreement. This drawing shall also not be misapplied.



Technical Data / Technische Daten

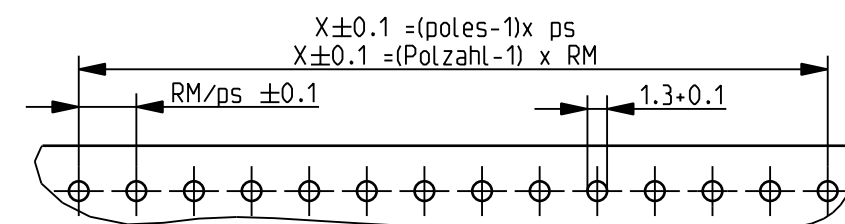
Insulation coordinatin according
to DIN/VDE 0110-1 04.97
Isolationskoordination
nach DIN/VDE 0110-1 04.97

	UL		VDE	
	0.15 in	0.3in	3.81mm	7.62mm
pin spacing / Rastermaß			160V~eff	250V~eff
voltage / Bemessungsspannung	300V	600V	according to VDE 0110	
			degree of contamination 3	
			nach VDE 0110 Verschmutzungsgrad 3	
surge voltage			2.5kV	4kV
Bemessungs-Stossspannung			at overvoltage category III	
			bei Überspannungskategorie III	
Insulation material group			insulating material I: 600 < CTI	
Isolierstoffgruppe			Isolierstoff I: 600 < CTI	
minimum clearances or creepage distances			3.01mm	6.82mm
Kleinste Luft- oder Kriechstrecke				
maximum current / Bemessungsstrom		8A		8A
contact pin / Kontaktstift		☐ 0.8mm		
soldering pin / Lötstift		☐ 0.8mm		
			recommended pc hole diameter Ø1.3mm	
			empfohlene Bohrung in der Leiterplatte Ø1.3mm	
soldering pin length			Typ 190=3.5mm ; Typ 191=3.25mm	
Lötstiftlänge				
max thichnes PCB		1.5mm		
max zul. Leiterplattendicke				
max. limiting temperature		+105 ° C		
Obere Grenztemperatur				
min. limiting temperature		-40 ° C		
Untere Grenztemperatur				
soldering temperature		max 260 °C (90sec.)		
Löttemperatur				
climatic class		40/105/56 according to IEC 68-1		
Klimatische Klasse		40/105/56 nach IEC 68-1		
number of poles / Polzahl		2-16 poles / polig		
approvals / Approbationen				

Materials / Werkstoffe:

Pos. 1	Gehäuse Stl.	PA46GF30 UL 94 V0 schwarz
item 1	insulation body	PA46GF30 UL 94 V0 black
Pos. 2/3	Kontaktstift	CuMg 0.1 gal Ni2 +5µm glanzverzinnt Sn100
item 2/3	contact pin	CuMg 0.1 gal Ni2 +5µm glanzverzinnt Sn100

Lochbild in der Leiterplatte
drill pattern in the PBC



Verwendungsbereich				Zul.Abw.	Oberfläche	Maßstab 5:1	Gewicht
						Werkstoff, Rohteil	Werkstoff-Artikelnummer
				Datum	Name	Benennung	
				Bearb.: 20.09.02	W äschle	Datenblatt/data sheet Stiftleiste Typ 190/191 RM 3.81 header type 190/191 ps 3.81	
				Gepr.: 21.08.08	StadlerH		
				Norm			
						Artikelnummer	Teile-Code
C	ÄM 4682	08.09.08	An.	RIA		31190/31191	Blatt 1
B	ÄM 4648	20.08.08	An.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	CAD-Nr.:	ENG-016762	Ers.d.:	Ers.f.: